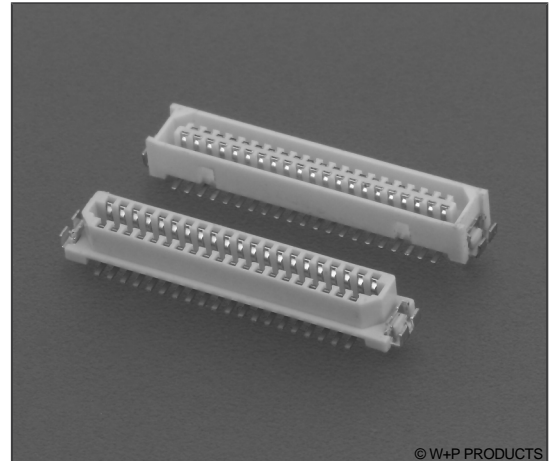
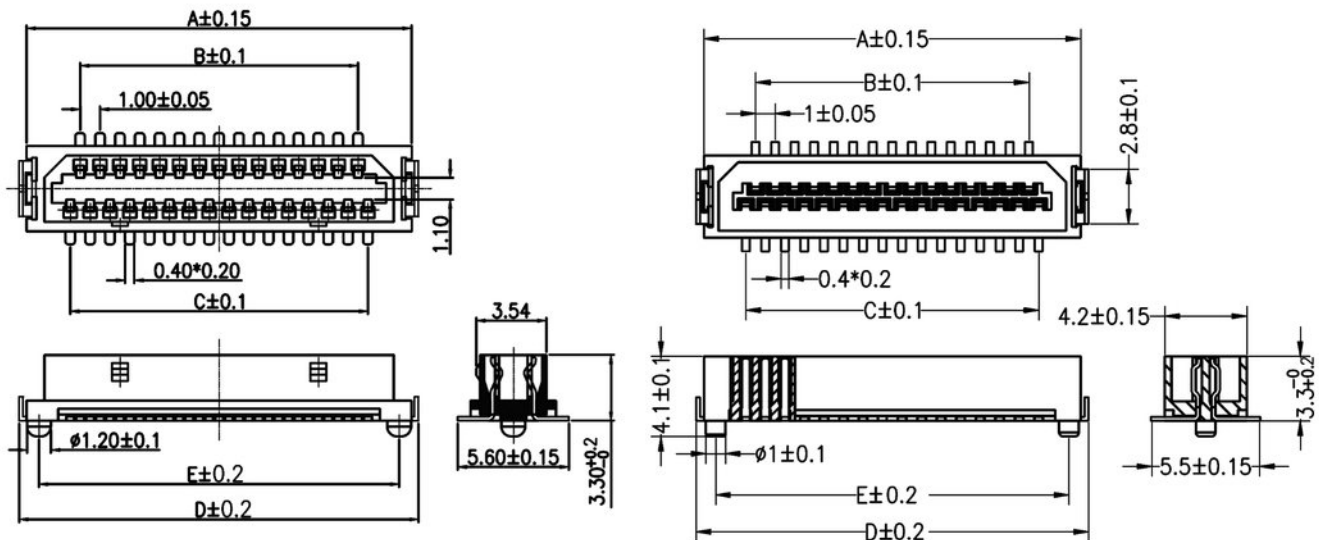


### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to plating options, over Ni
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	200 V <sub>AC</sub>
Test Voltage	200 V <sub>AC</sub>
Nennspannung	50 V AC/DC
Voltage Rating	50 V <sub>AC</sub>
Nennstrom	500 mA
Current Rating	500 mA
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering

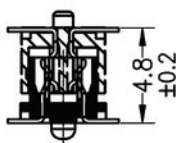


© W+P PRODUCTS

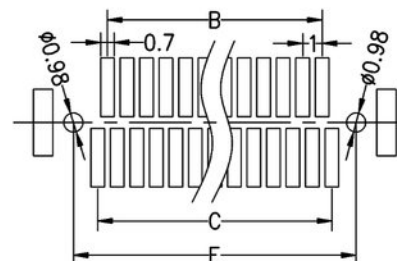


Recommended P.C.B Layout (Top Side)  
(PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)

ASSEMBLY



NO. OF Contacts	Dimensions				
	A	B	C	E	D
31 pin	19.40	14.00	15.00	18.10	21.10
41 pin	24.40	19.00	20.00	23.10	26.10
51 pin	29.40	24.00	25.00	28.10	31.10



<b>Serie</b>	<b>Type*</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Plating*</b>	<b>Package</b>
<b>5101</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>00</b>	<b>ST</b>
	1 Male 2 Female	31/41/51	00 Au flash 60 Sel. Au/Sn	ST In Stangen In tubes

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

